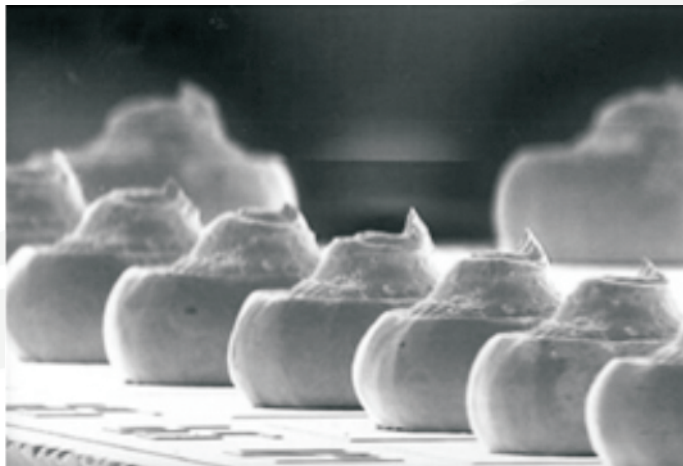


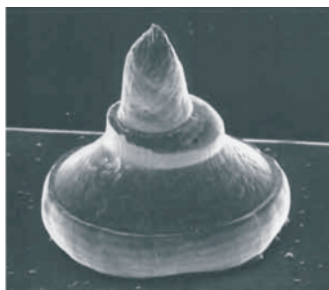
## POST PROCESS SUR CHIP



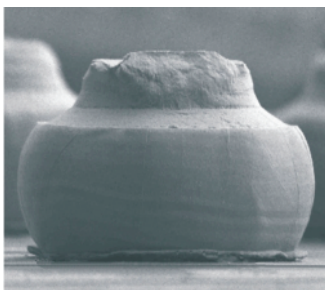
DIAMÈTRE : 60 - 120 $\mu$ m  
HAUTEUR : 45 - 60 $\mu$ m  
CADENCE : JUSQU'À 35 BUMPS/SEC

BUMPING SUR :  
- WAFER JUSQU'À 12"  
- BLUE FOIL  
- WAFER SCIÉ  
- UNITAIRES

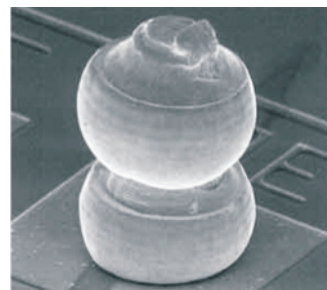
**STANDARD BUMP**



**ACCU BUMP**

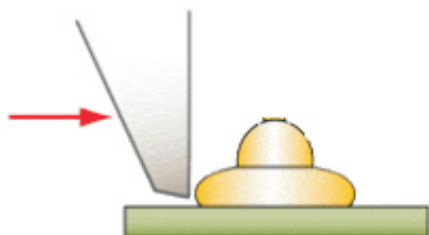


**STACKED ACCU BUMP**



**HYBRID SA** EST À MÊME D'EFFECTUER LE BUMPING DE CHIPS SUR WAFER. LA FORME DU BUMP EST DÉFINIE EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT POUR QU'IL CORRESPONDE AUX SPÉCIFICITÉS D'ASSEMBLAGE DU CHIP.

## SHEAR TEST



APPLICATION DE LA FORCE JUSQU'À RUPTURE DU BUMP